证券代码: 605166 证券简称: 聚合顺 公告编号: 2024-014

转债代码: 111003 转债简称: 聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次授信额度: 杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"公司")及 子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 40 亿元。
- 公司于 2024 年 03 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、申请综合敞口授信额度基本情况

公司及子公司根据经营需要及市场行情变化,结合财务状况,向银行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 40 亿元。有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。

为了提高决策效率,在相关金融机构办理以上额度和期限内的综合融资业务, 拟授权董事长傅昌宝先生将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权 董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件,包括 但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同、业务相关的其他协议以及其他法律文 件等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、备查文件

- 1. 第三届董事会第二十一次会议决议;
- 2. 第三届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2024年03月29日